



BEYOND CONNECTION

- SMIC MOBILITY, INSIGHT CONNECTIONS! -

国際カーエレクトロニクス技術展出展のご案内

お客様各位

拝啓 貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、弊社は来る2019年1月16日から1月18日までの3日間、東京ビッグサイトにて行われる「第11回国際カーエレクトロニクス技術展」に出展致します。

本展示会は、「第48回ネプコンジャパン」と同時開催となります。

自動車産業は100年に1度と言われる変革期を迎えております。

弊社としてもEV・Power・IoT・AIを重要な事業領域と捉え、お客様のご支援につながるはんだ材料とFA装置の提案を行います。

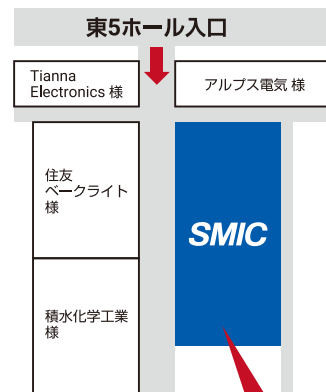
ご多用とは存じますが、是非弊社ブースにご来場いただき、展示致します製品をご高覧くださいませよう、ご案内申し上げます。

敬具

千住金属工業株式会社
代表取締役社長 鈴木 良一

最寄り駅

- ・りんかい線「国際展示場駅」より 徒歩約7分
- ・ゆりかもめ「国際展示場正門駅」より 徒歩約3分



ブース番号
E43-4
(第5ホール入口すぐ)

BEYOND CONNECTION - SMIC MOBILITY, INSIGHT CONNECTONS! -



第11回オートモーティブワールド 内

第11回 **国際カーエレクトロニクス技術展**
(カーエレJAPAN)

会期 2019年1月16日(水)～18日(金) 10:00～18:00
(18日のみ17:00終了)

会場 東京ビッグサイト E43-4 第5ホール入口すぐ

展示内容

マテリアル・ソリューション

- 低温はんだ材料
- ソルダプリフォーム材料
- 残渣割れ抑制はんだ材料

マシン・ソリューション

- ディップはんだ付け装置 LPD-2019M
- エコパスカル SPF2-400 (SKオプション搭載)

ブース内プレゼンテーション

EVを中心にしたV2Xへの製品提案

- AIやセンシングへの提案
～ 低温はんだ材料 ～
- 再生エネルギーへの提案
～ ソルダプリフォーム材料 ～

責任者が語る 来るEV化とその先のV2Xに向けた千住金属工業の取り組み

- グローバルで進むEV化に対応した体制
国際事業部門 秋田 智 統轄部長
- V2X時代に向けたはんだ材料開発
開発・技術部門 島村 将人 部長

他会場セミナー

1月16日(水) 9:30～12:00 会場 会議棟

ネプコンジャパンセミナー/専門セッション

発表内容

車載向け
高信頼性はんだ材料



発表者

開発・技術部 ハンダテクニカルセンター
上級研究員 吉川 俊策

*主催者Webサイトでの事前申し込みが必要です。

1月18日(金) 12:20～13:20 会場 東ホール2階 商談室

出展社による製品・技術セミナー

発表内容

EV・自動運転化に向けた
接合アプローチ



発表者

開発・技術部 ハンダテクニカルセンター
部長 島村 将人

*受講無料・事前申し込み不要ですが、定員は当日先着50名様までとなります。

詳細な会場は会期1週間前までに主催者WEBサイトに掲示されます。

千住金属工業株式会社

CSR・広報宣伝部
120-0038 東京都足立区千住橋戸町23番地
TEL 03-3888-5151 / FAX 03-3870-5501
www.senju.com

SMIC